

Bâti de gravure plasma R.I.E. (Reactive Ion Etching)



- ✓ Gravure plasma
- ✓ Activation de surface (créer des liaisons pendantes)
- ✓ Lignes de gaz Oxygène et CF₄

Exemple de réalisations : Guides optiques et microcavités laser

Caractéristiques

- Marque : Plasma Technology
- Type : Plasmalab μP
- Temps d'attaque programmables.
- Gaz Oxygène seulement.
- Puissance RF ajustable : 27 à 100W.